



SÜSS MicroTec AG

NEUNMONATSBERICHT

01. Januar – 30. September 2004



I KENNZAHLEN Q3/2004

Millionen Euro	Q2/04	Q3/04	Q1-Q3/03	Q1-Q3/04
Auftragseingang netto	36,1	32,4	76,4	92,8
Auftragsbestand netto	--	--	43,8	48,9
Nettoumsatz	26,6	31,7	60,6	77,5
Eigenkapital	--	--	107,0	98,8
Eigenkapitalquote	--	--	72,4%	64,3%
Liquide Mittel (netto)	--	--	9,8	15,7
Free Cash Flow	-1,0	-4,0	0,2	-5,0
Rohertrag	9,9	15,0	23,2	31,1
Rohertragsmarge	37,4%	47,3%	38,3%	40,2%
EBITDA	-1,1	4,1	-10,5	-1,3
EBIT	-2,5	2,8	-15,2	-5,3
EAT (Ergebnis nach Steuern)	-2,7	1,4	-10,1	-6,2
EPS (Ergebnis pro Aktie in Euro)	-0,18	0,09	-0,67	-0,41
Anzahl der Mitarbeiter	--	--	711	747

INHALT

Editorial	4
Neues Vorstandsmitglied	8
Dr. Schneidewind übernimmt Bereiche Produktion und Technik	8
Neue Kooperation	10
Mit IBM in die technologische Zukunft	10
Zufriedene Kunden	13
Erneut beste Ergebnisse bei VLSI-Umfrage	13
Umsatz und Auftragslage	16
Umsatzentwicklung nach Produktlinien und Regionen	16
Auftragseingang nach Produktlinien und Regionen	17
Finanzbericht	18
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	18
Konzernbilanz	20
Konzernkapitalflussrechnung	22
Konzerneigenkapitalentwicklung	24
Rechnungslegungsgrundsätze / Segmentberichterstattung	24
Aktien und Bezugsrechte der Organe	26

Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG,

der Aufschwung in der Halbleiterindustrie spiegelt sich inzwischen deutlich in unserer Geschäftsentwicklung wider. Unsere wesentlichen Kennzahlen entwickelten sich erfreulich positiv. Auch der Auftragseingang lag im dritten Quartal mit 32,4 Millionen Euro wieder klar über der 30 Millionen-Schwelle. Damit liegen wir erneut über dem Niveau, auf dem wir uns von Ende 2002 bis Anfang 2004 bewegten und das weit unter 30 Millionen Euro pro Quartal lag.

Die Umsatzentwicklung zeigt die stärkste Verbesserung. Im dritten Quartal stieg der Umsatz von SÜSS MicroTec auf 31,7 Millionen Euro. Damit lag er 48 Prozent über dem Vorjahreswert (21,4 Millionen Euro) und 19 Prozent höher als im zweiten Quartal 2004.

Bei der Rohertragsmarge gab es einen Anstieg auf 47,3 Prozent. Im Vorjahreszeitraum lag sie noch bei 42,0 Prozent; im zweiten Quartal des laufenden Jahres bei 37,4 Prozent. Den Rohertrag konnten wir im Vergleich zum Vorjahreswert um 66 Prozent auf 15 Millionen Euro verbessern. Gegenüber dem zweiten Quartal lag er um 51 Prozent höher (Q2/2004: 9,9 Millionen Euro). Wesentlich für die sehr gute Marge war im dritten Quartal der Produktmix, wo insbesondere 200mm- und 300mm-Produktionsequipment den Schwerpunkt bildeten.

Wichtiger Indikator unserer positiven Geschäftsentwicklung ist die weitere Verbesserung des EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen). Im abgelaufenen Quartal erreichte es plus 4,1 Millionen Euro – nach minus 0,3 Millionen Euro im Vorjahreszeit-



raum und minus 1,1 Millionen Euro im zweiten Quartal 2004. Auch das Ergebnis nach Steuern zeigte im dritten Quartal eine deutlichere Verbesserung auf plus 1,4 Millionen Euro.

Der Free Cash Flow im dritten Quartal betrug minus 4,0 Millionen Euro und war geprägt von umsatzbedingt deutlich gestiegenen Forderungsbeständen (plus 6,8 Millionen Euro). Der Lagerbestand stieg im Vergleich zum Vorquartal nochmals leicht an, was vor allem auf die Vorfertigung für die geplanten Lieferungen im vierten Quartal zurückzuführen ist.

Die positive Geschäftsentwicklung im abgelaufenen dritten Quartal ist besonders auf die erhöhte Equipment-Nachfrage für Advanced Packaging und Mikrosystemtechnik zurückzuführen. Hier zeichnet sich eine stetig wachsende Nachfrage ab – und damit eine konstant positive Entwicklung unserer Hauptmärkte. Unsere 2003 in den Markt eingeführten Technologieneuheiten "SupraYield" und "nanoPREP" werden vom Markt mit großem Interesse aufgenommen.

Wichtige Basis unserer starken Marktposition ist die intensive und innovative Forschungs- und Entwicklungsarbeit von SÜSS MicroTec. Das im September 2004 geschlossene Technologie-Abkommen mit IBM, ist ebenfalls auf unsere hohe technologische Kompetenz zurückzuführen bei gleichzeitig äußerst günstiger Cost of Ownership. Diese Kooperation mit einem der weltweit größten Unternehmen der Informationstechnologie ermöglicht uns künftig einen zusätzlichen – und potenziell weitreichenden – Wachstumsschub. Auf Grundlage der von IBM patentierten C4NP-Technologie entwickeln wir das komplette Produktionsequipment für das



Solder Bumping im 200mm- und 300mm-Bereich. Die Maschinen mit C4NP-Technologie ermöglichen einen bleifreien Bumping-Prozess bei der Massenfertigung von Chips, während gleichzeitig die Produktionskosten weiter gesenkt werden. Elektronik wird somit letztlich nicht nur zuverlässiger, vielfältiger und günstiger, sondern auch umweltfreundlich. Gemeinsam mit IBM gestalten wir ab sofort diese neue elektronische Zukunft. Ausführliche Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auf Seite 10.

Aus strategischer Sicht müssen wir die finanzielle Performance des Unternehmens insbesondere in Abschwungphasen deutlich steigern. Die Unternehmensstruktur der SÜSS MicroTec-Gruppe muss effektiv und effizient sein; eine kontinuierliche Überprüfung dieser Strukturen und marktbedingte Anpassungen sind daher unabdingbar. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis Ende 2006, auf Basis des heutigen Geschäftsvolumens, den Break Even bereits bei einem Umsatz von rund 100 Millionen Euro zu erreichen – statt derzeit bei 115 bis 120 Millionen Euro. SÜSS MicroTec ist dann auch in einem zyklischen Geschäftsumfeld besser in der Lage, positive Ergebnisse zu erwirtschaften. Zur Umsetzung dieses wichtigen Zieles wurde auch der Vorstand erweitert. Seit 1. September hat die SÜSS MicroTec AG wieder ein dreiköpfiges Vorstandsteam. Neues Mitglied ist Dr. Stefan Schneidewind, der die Bereiche Produktion und Technik verantwortet (weitere Informationen auf Seite 8).

In seiner Verantwortung für das Unternehmen und die Aktionäre, die Eigentümer des Unternehmens sind, muss der Vorstand auch schwerwiegende Entscheidungen treffen. Mit Blick auf die Senkung des Break Even beabsichtigen wir, wie bereits mitgeteilt, die Schließung des Werkes Aßlar und die Verlagerung der dortigen



Produktion nach Garching. Aus dieser Maßnahme erwarten wir Kosteneinsparungen von über 4 Millionen Euro jährlich; etwa 2,5 Millionen Euro davon entfallen auf Personalkosten. Wir sind uns der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern in Aßlar bewusst und werden zusammen mit dem Betriebsrat versuchen, eine möglichst sozialverträgliche Lösung zu finden.

Mit unserer planmäßig verlaufenden Geschäftsentwicklung im dritten Quartal bestätigen wir unser Umsatzziel des laufenden Jahres von 115 bis 120 Millionen Euro und damit auch das Erreichen eines ausgeglichenen EBIT. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Entwicklungen (weiterer Wertverfall des US-Dollar und eventuelle Sondereffekte aus der Restrukturierung) das Geschäftsjahr 2004 noch außerordentlich belastet werden könnte.

Für die Zukunft werden die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen die Performance von SÜSS MicroTec und unsere weitere positive Unternehmensentwicklung zusätzlich stärken.

Garching, im November 2004,
der Vorstand

I NEUES VORSTANDSMITGLIED

Dr. Schneidewind übernimmt Bereiche Produktion und Technik

Dr. Stefan Schneidewind (49) verstärkt seit 1. September 2004 das Vorstandsteam der SÜSS MicroTec AG. Er übernimmt die Bereiche Produktion und Technik, die bisher zusätzlich von Dr. Franz Richter (Vorstandsvorsitzender) und Stephan Schulak (Finanzvorstand) verantwortet wurden.

Hintergrund für die Neustrukturierung im Vorstand ist die sich ausweitende Geschäftstätigkeit der SÜSS MicroTec-Gruppe und die deutliche Verbesserung des Marktumfelds. Definiertes Ziel des Vorstandes ist es, unter diesen Rahmenbedingungen in den nächsten 1 bis 2 Jahren den Break Even auf EBIT-Basis bereits bei einem Umsatz rund 100 Millionen Euro zu erreichen. Dadurch soll die Position von SÜSS MicroTec in der zyklischen Halbleiterindustrie gestärkt werden. Im laufenden Geschäftsjahr liegt der Break Even auf EBIT-Niveau noch bei etwa 115 bis 120 Millionen Euro, was auch der Umsatzprognose für 2004 entspricht.

Dr. Stefan Schneidewind studierte bis 1979 an der Technischen Universität Dresden Elektrotechnik mit dem Abschluss Diplom-Ingenieur. Anschließend promovierte er am Institut für Mikrosystemtechnik, ebenfalls in Dresden, im Bereich angewandte Lasertechnik. Seine berufliche Laufbahn startete er als wissenschaftlicher Assistent an der Technischen Universität Dresden; 1984 wechselte er als Entwicklungsingenieur zur VEB Wägetechnik Rapido. 1989 erfolgte dann der Einstieg in die SÜSS MicroTec-Gruppe. Nach leitenden Tätigkeiten im Bereich Forschung und Entwicklung in Deutschland und in den USA und als Business




Unit Manager der damaligen Karl Suss America Inc. übernahm er Anfang 2000 als Geschäftsführer die Verantwortung für SÜSS MicroTec Test Systems in Sacka bei Dresden (100%ige SÜSS MicroTec-Tochter). Unter seiner Leitung erwirtschaftete SÜSS MicroTec Test Systems selbst in der äußerst schwierigen Marktphase der letzten Jahre stets positive Ergebnisse und konnte mit innovativen neuen Produkten ihre Marktposition deutlich stärken.

I NEUE KOOPERATION

Mit IBM in die technologische Zukunft

SÜSS MicroTec und IBM gehen mit einem gemeinsamen Technologie-Abkommen neue Wege bei der Chipverbindung. Ziel ist die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von IBMs wegweisender und patentierter C4NP Packaging-Technologie.

C4NP steht für Controlled Collapse Chip Connection New Process und bezeichnet die Flip Chip Bonding-Technologie der nächsten Generation. Bereits in den späten 60er Jahren stellte IBM mit dem C4-Prozess die Weichen für das Flip Chip Bonding; 1973 wurde diese Technologie erstmals im "IBM System 3" eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen "IBM C4" Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. Der neue Prozess C4NP basiert auf dieser bewährten C4-Lösung. IBM gelang hiermit wieder ein entscheidender Durchbruch für das Wafer Bumping. Erstmals vereint eine technische Lösung 100%ige Bleifreiheit, hohe Zuverlässigkeit, Fine Pitch-Fähigkeit, niedrige Materialkosten und die Flexibilität, praktisch alle Lotzusammensetzungen zu verwenden. Für unsere Kunden, die Chipproduzenten, bedeutet das: C4NP ist eine Prozesslösung, die vorrangig das wichtigste Thema der Halbleiterindustrie adressiert – die Kosten. Dank einer neuen Verfahrenstechnik bei der Erstellung der Lotkügelchen wird C4NP auch bei der Verwendung von heute üblichen Lotzusammensetzungen die Prozesskosten senken. Zusätzlich wird das Thema "bleifrei" vor allem beim Endverbraucher immer wichtiger. Abgesehen von gesetzlichen Anforderungen sind umweltfreundliche Produkte immer mehr „en vogue“, so dass ein erheblicher Druck auf die Gerätehersteller



aufgebaut wird. C4NP bietet für alle diese Belange eine attraktive Lösung.

Seit einiger Zeit ist die Industrie auf der Suche nach einer Technologie, die diesen Anforderungen entspricht. IBMs C4NP ermöglicht den Halbleiterherstellern die Umsetzung eines 100% bleifreien Solder Bumping-Prozesses als integraler Bestandteil ihrer Wafer Test-, Assembly- und Packaging-Verfahren. Für den Endnutzer bedeutet das: Die neue Generation von Handys oder Laptops wird nicht nur leistungsfähiger und günstiger, sondern endlich auch 100% bleifrei sein – also umweltfreundlich und damit ohne Schadstoffe, die negative gesundheitliche Auswirkungen haben können.*

SÜSS MicroTec wird diesen wegweisenden C4NP-Prozess jetzt kommerzialisieren. Für IBM waren bei der Wahl von SÜSS MicroTec als Kooperationspartner folgende Kriterien entscheidend: Die marktführende Position bei Advanced Packaging-Produktionsgeräten mit äußerst niedriger Cost of Ownership; die bereits vorhandenen Produkte und Technologien, die für C4NP geeignet sind sowie SÜSS MicroTecs jahrzehntelange intensive und erfolgreiche Tätigkeit im Advanced Packaging-Markt. Aus Sicht von IBM erfüllte kein anderer Equipment-Hersteller diese gewünschten Kriterien.

Im Detail sieht die Kooperation folgende Schritte vor: SÜSS MicroTec entwickelt das Equipment für eine komplette C4NP-Produktionslinie. Die hierfür benötigten C4NP-Tools basieren im Wesentlichen auf der jetzigen SÜSS MicroTec-Kerntechnologie



(Mask Aligner, Device Bonder und Prober) – nur so ist eine zeitnahe Markteinführung überhaupt möglich. Diese bereits bestehenden Produkte werden weiterentwickelt und dann dem Markt als eigenständige Produktlinie angeboten. Die Finanzierung für die Entwicklung übernimmt IBM Global Financing (IBM Deutschland Kreditbank GmbH). IBM wird dann an den Standorten der SÜSS MicroTec-Kunden spezifische Prozesstrainings durchführen – und gewährleisten so, dass die Kunden den größtmöglichen Nutzen aus dem neuen Equipment ziehen können. Des Weiteren wird IBM die Weiterentwicklung und Prozessoptimierung von C4NP fortsetzen und SÜSS MicroTec über die aktuellen Entwicklungen informieren.

Diese Details verdeutlichen die Bedeutung des weitreichenden Abkommens für SÜSS MicroTec. Die erfolgreiche Entwicklung von C4NP-Produktionsmaschinen eröffnet SÜSS MicroTec in diesem wichtigen Zukunftsbereich eine einzigartige Marktposition unter den Equipment-Lieferanten – und ein erhebliches Wachstumspotenzial. Denn das C4NP-Equipment steht nicht ausschließlich IBM zur Verfügung; es wird an alle potenziellen Kunden vermarktet. Dadurch kann sich für SÜSS MicroTec aus heutiger Sicht der Umsatz im Bereich Advanced Packaging mittelfristig verdreifachen.

*Vergleiche hierzu auch die geplante Umweltgesetzgebung der Europäischen Union (EU-Richtlinie „RoHS“ zur Schadstoffreduzierung) und die Umweltnormen Japans („Green Purchasing Act“), die vorsehen, dass Chips, die umweltgefährdende Stoffe wie Blei enthalten, künftig nicht mehr von Elektronikherstellern verarbeitet werden dürfen.

I ZUFRIEDENE KUNDEN

Erneut beste Ergebnisse bei VLSI-Umfrage

SÜSS MicroTec bietet seinen Kunden weiterhin Service & Support auf höchstem Niveau. Das ergab auch die diesjährige Umfrage von VLSI Research („10 Best Annual Customer Satisfaction Survey on Chip Making Equipment Suppliers“). In vier Kategorien gab es Top-Platzierungen für das Garching Unternehmen – für SÜSS MicroTec eine Bestätigung seiner anhaltend intensiven Zusammenarbeit mit den Kunden. Platz 1 erreicht SÜSS MicroTec in der Kategorie „Test & Measurement“. Im Bereich „Wafer Processing“ steht das Garching Unternehmen auf Platz 3; beim Segment „Assembly Equipment“ auf Rang 4. In der erst 2002 eingeführten Kategorie „Focused Suppliers of Chip Making Equipment“ belegt SÜSS MicroTec Platz 10.

Nach den Ergebnissen der VLSI-Umfrage erhält SÜSS MicroTec somit bereits seit 11 Jahren in Folge Spitzennoten für seine Kundenorientierung – und damit seit Beginn der VLSI-Datenerhebung zur Kundenzufriedenheit.

Seit 1993 bewertet VLSI Research jährlich detailliert den Kundenservice von Equipment-Lieferanten. Die renommierte Umfrage ist zudem die einzig publizierte Befragung zur Kundenzufriedenheit. Dafür werden Fragebögen an Entscheidungsträger in Halbleiterunternehmen versendet – 2004 waren es rund 41.000. Nutzer von Halbleiter-Produktionsanlagen werden hierbei um eine Einstufung ihrer Zulieferer in über 10 Kategorien gebeten, die wiederum als exemplarisch für Lieferanten-Kunden-Beziehungen



gilt. In die diesjährige Auswertung konnten pro Kategorie rund 2.000 zurückgesendete Unternehmensbewertungen einfließen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.vlsiresearch.com

I SÜSS MicroTec AG

ANHANG

Umsatz	16
Auftragseingang	17
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	18
Konzernbilanz	20
Konzernkapitalflussrechnung	22
Konzerneigenkapitalentwicklung	24
Rechnungslegungsgrundsätze	24
Segmentberichterstattung	24
Aktien- und Bezugsrechte der Organe	26

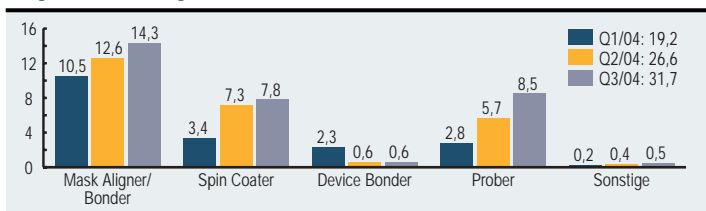
SÜSS MicroTec AG

UMSATZ

Der Gesamtumsatz von 31,7 Mio. Euro in Q3/2004 bzw. von 77,5 Mio. Euro in Q1-Q3/2004 teilt sich nach Produktlinien und Regionen wie folgt auf:

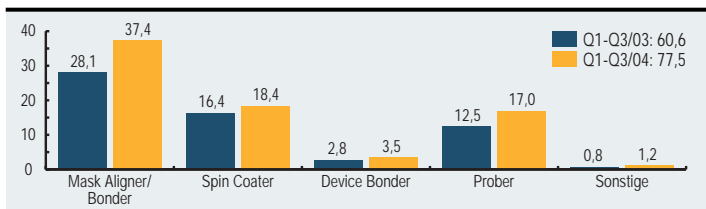
Umsatzentwicklung nach Produktlinien (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



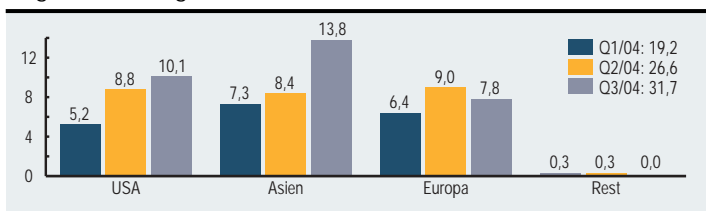
Umsatzentwicklung nach Produktlinien (9 Monate)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



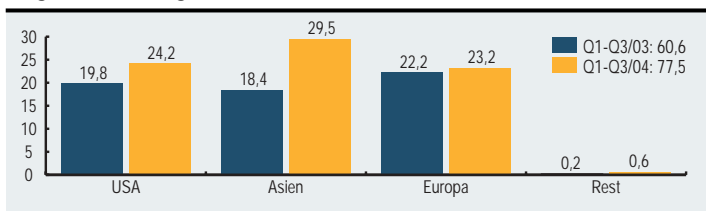
Umsatzentwicklung nach Regionen (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Umsatzentwicklung nach Regionen (9 Monate)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



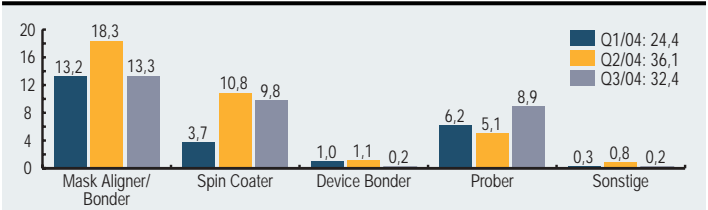
SÜSS MicroTec AG

AUFTRAGSEINGANG

Der Auftragseingang von 32,4 Mio. Euro in Q3/2004 bzw. von 92,8 Mio. Euro in Q1-Q3/2004 teilt sich nach Produktlinien und Regionen wie folgt auf:

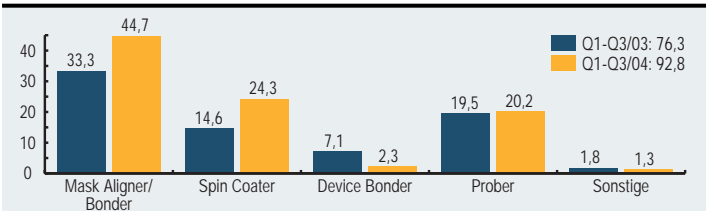
Auftragseingang nach Produktlinien (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



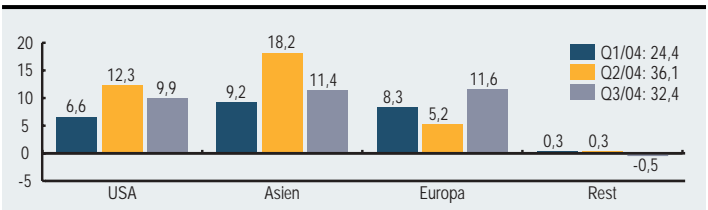
Auftragseingang nach Produktlinien (9 Monate)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



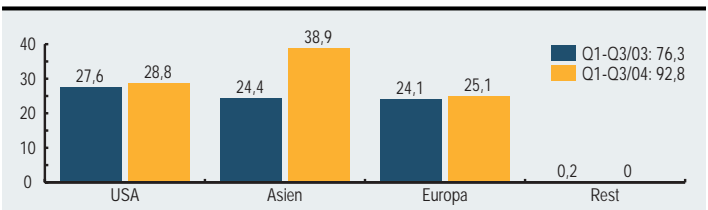
Auftragseingang nach Regionen (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Auftragseingang nach Regionen (9 Monate)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



SÜSS MicroTec AG

KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR

Umsatzerlöse

Frachtkosten und Provisionen

Umsatzerlöse netto

Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen

Bruttoergebnis vom Umsatz

Allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten

Forschungs- und Entwicklungskosten

Abschreibung des Firmenwerts

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Erträge / Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung

Operatives Ergebnis

Zinsaufwendungen

Zinserträge

Anteil der Minderheitsaktionäre am Ergebnis

Ergebnis vor Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

Earnings before Interest and Taxes (EBIT)*

Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)*

Pro Aktie:

Unverwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR

Verwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR

Überleitung zum Comprehensive Income

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

Sonstiges Comprehensive Income nach Steuern

Fremdwährungsdifferenzen

Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellungen

Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren

Comprehensive Income

* ungeprüft

01.07.2003- 30.09.2003*	01.01.2003- 30.09.2003*	01.01.2003- 31.12.2003	01.07.2004- 30.09.2004*	01.01.2004- 30.09.2004*
21.973	62.438	95.500	32.486	79.681
-533	-1.824	-2.885	-826	-2.216
21.440	60.614	92.615	31.660	77.465
-12.432	-37.401	-56.168	-16.687	-46.345
9.008	23.213	36.447	14.973	31.120
-9.984	-31.306	-40.985	-10.244	-30.361
-1.908	-6.826	-10.496	-2.262	-7.380
0	0	0	0	0
977	1.601	859	560	1.130
152	-1.877	-2.916	-179	208
-1.755	-15.195	-17.091	2.848	-5.283
-330	-955	-1.245	-418	-1.187
114	293	358	121	308
4	-18	24	-25	-13
-1.967	-15.875	-17.954	2.526	-6.175
628	5.731	3.401	-1.120	-44
-1.339	-10.144	-14.553	1.406	-6.219
-1.751	-15.213	-17.067	2.823	-5.296
-288	-10.458	-10.996	4.103	-1.304
-0,09	-0,68	-0,97	0,09	-0,41
-0,09	-0,67	-0,97	0,09	-0,41
-1.339	-10.144	-14.553	1.406	-6.219
-20	-1.860	-2.255	-126	306
0	0	-14	0	0
0	0	47	0	0
-1.359	-12.004	-16.775	1.280	-5.913

SÜSS MicroTec AG

KONZERNBILANZ

TEUR	30.09.2003*	31.12.2003	30.09.2004*
AKTIVA			
Flüssige Mittel	13.040	26.785	19.571
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	18.142	23.606	24.557
Sonstige kurzfristige Forderungen	4.914	6.603	3.382
Vorräte, netto	47.622	41.900	48.671
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	862	1.094	1.084
Kurzfristige aktive latente Steuern	4.632	2.091	2.441
Summe Umlaufvermögen	89.212	102.079	99.706
Sachanlagen	13.471	11.935	9.914
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.922	7.305	5.958
Goodwill	28.009	28.009	28.009
Finanzanlagen	148	144	144
Langfristige aktive latente Steuern	7.175	7.480	7.931
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	1.889	1.901	1.854
Summe Anlagevermögen	58.614	56.774	53.810
Summe Aktiva	147.826	158.853	153.516

* ungeprüft

TEUR	30.09.2003*	31.12.2003	30.09.2004*
PASSIVA			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	3.240	3.154	3.890
Kurzfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	154	158	130
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.751	5.972	6.848
Kurzfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	223	214	212
Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	2.917	2.991	2.394
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	14.130	16.929	18.597
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	24.415	29.418	32.071
Langfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	11.585	22.423	18.215
Langfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	509	473	399
Langfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	3.653	3.581	3.573
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	621	517	457
Minderheitenanteil an Konzerngesellschaften	37	32	45
Summe langfristige Verbindlichkeiten	16.405	27.026	22.689
Gezeichnetes Kapital, genehmigte Anzahl von Aktien zu EUR 1,00 (in tsd.) 22.635 (30.09.2004) und genehmigte Anzahl von Aktien zu EUR 1,00 (in tsd.) 22.423 (31.12.2003); davon ausgegeben (in tsd.) 15.157 (30.09.2004) bzw. 14.957 (31.12.2003)	14.957	14.957	15.157
Kapitalrücklage	81.387	81.561	83.621
Gewinnrücklagen	433	433	433
Gewinnvortrag	15.493	11.084	4.865
Kumuliertes Other Comprehensive Income	-5.264	-5.626	-5.320
Summe Eigenkapital	107.006	102.409	98.756
Summe Passiva	147.826	158.853	153.516

* ungeprüft

SÜSS MicroTec AG

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.2003- 30.09.2003*	01.01.2003- 31.12.2003	01.01.2004- 30.09.2004*
Mittelab-/zufluss aus der laufenden			
Geschäftstätigkeit			
Jahresfehlbetrag	-10.144	-14.553	-6.219
Wechselkursbedingte Veränderung des kurzfristigen Nettovermögens	-913	134	162
Anpassung zur Überleitung des Jahresfehlbetrages zum Mittelab-/zufluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit			
Zuführung zur Kapitalrücklage für Bezugsrechte	476	650	300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.412	1.965	1.378
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	2.988	3.784	2.491
Abschreibungen auf Leasinggegenstände	356	322	123
Veränderung der aktiven latenten Steuern	-3.507	-1.271	-801
Verlust / Gewinn aus Abgang von Anlagegegenständen	37	551	0
Gewinn aus Beteiligungen	0	4	0
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	135	333	-352
Veränderung der Wertberichtigung auf Vorräte	843	337	949
Veränderungen von Aktiva und Passiva			
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.828	10.166	-599
Veränderung der Vorräte	-403	5.825	-7.720
Veränderung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	96	366	10
Veränderung der sonstigen Aktiva	4.386	2.685	3.268
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-183	2.038	876
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	-10.302	-7.503	1.668
Veränderung der Pensionsverbindlichkeiten	73	-8	-10
Veränderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten	-129	-238	-47
Mittelab-/zufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.049	5.587	-4.523

* ungeprüft

TEUR	01.01.2003- 30.09.2003*	01.01.2003- 31.12.2003	01.01.2004- 30.09.2004*
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-825	-1.010	-537
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-38	-10	-4
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Finanzanlagen	1	3	29
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-862	-1.017	-512
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus der Begebung einer Wandel- und Optionsanleihe	0	11.642	0
Kosten der Wandel- und Optionsanleihe	0	-502	0
Tilgung von Bankdarlehen	-3.545	-4.275	-2.845
Änderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-291	-377	736
Tilgungen / Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	-225	-257	-102
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4.061	6.231	-2.211
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.874	10.801	-7.246
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	-724	-930	32
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	17.638	16.914	26.785
Finanzmittelbestand zum Ende der Periode	13.040	26.785	19.571
Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung			
Zinszahlungen während der Periode	1.017	773	1.084
Einkommensteuererstattungen/-zahlungen während der Periode inkl. Vorauszahlungen	-871	3.767	-1.550
Zusätzliche Darstellung nicht zahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungstätigkeiten			
Zugang zum Finanzierungsleasing	33	0	0
* ungeprüft			

SÜSS MicroTec AG

KONZERNEIGENKAPITALENTWICKLUNG

TEUR	Anzahl der Aktien in tausend Stück	Gezeichnetes Kapital
Stand 01.01.2003	14.957	14.957
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung		
Stand 30.09.2003	14.957	14.957
Stand 01.01.2004	14.957	14.957
Wandlung von Wandelschuldverschreibungen in Gezeichnetes Kapital	200	200
Zuführung aus der Wandlung von Wandelschuld- verschreibungen		
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung		
Stand 30.09.2004	15.157	15.157

Rechnungslegungsgrundsätze

Die dargestellten Angaben zum Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG entsprechen den Vorschriften der US-amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles („US-GAAP“). Der Zwischenabschluss zum 30. September 2004 wurde unter Beachtung derselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, die auch dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2003 zugrunde lagen und im Anhang ausführlich erläutert wurden.

Segmentberichterstattung

Die SÜSS MicroTec AG und ihre Tochterunternehmen sind lediglich in einem Segment tätig. Eine Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Segmente entfällt aus diesem Grund.

Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Gewinnvortrag	Kumuliertes Other Compre- hensive Income	Gesamt
80.911	433	25.637	-3.404	118.534
476				476
		-10.144		-10.144
			-1.860	-1.860
81.387	433	15.493	-5.264	107.006
81.561	433	11.084	-5.626	102.409
				200
1.760				1.760
300				300
		-6.219		-6.219
			306	306
83.621	433	4.865	-5.320	98.756

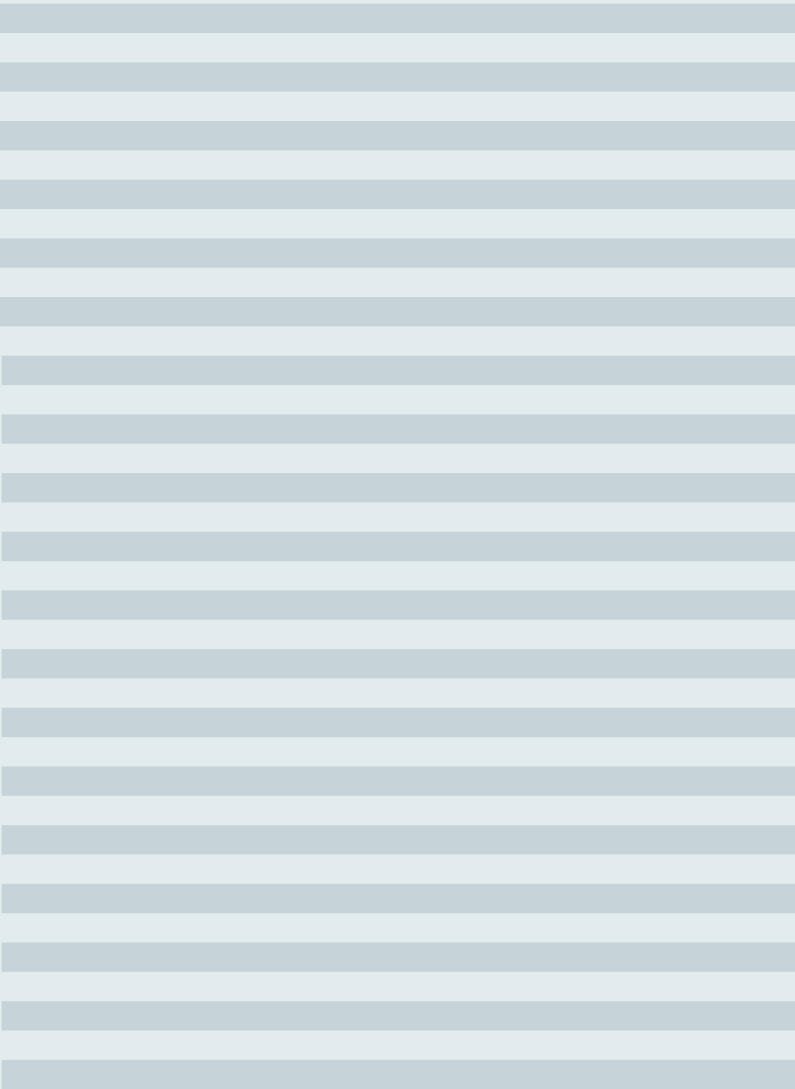
SÜSS MicroTec AG

AKTIEN UND BEZUGSRECHTE DER ORGANE

Aktien und Bezugsrechte der Organe	Aktien 31.12.2003	Optionen 31.12.2003	Aktien 30.09.2004	Optionen 30.09.2004
Vorstand				
Dr. Richter	400.000	105.000	400.000	145.000
S. Schulak	0	40.286	0	80.286
Dr. Schneidewind	0	15.440	0	35.648
Aufsichtsrat				
Dr. Süß (Vors.)	1.025.000	0	1.025.000	0
T. Schlytter-Henrichsen (stellv. Vors.)	6.909	0	6.909	0
Dr. h. c. Görtz	3.894	0	3.894	0
Prof. Dr. Heuberger	0	0	0	0
Dr. Schücking	500	0	500	0
Dr. Sesselmann	0	0	0	0



| NOTIZEN



I SÜSS MicroTec AG

Schleissheimer Strasse 90
D-85748 Garching

Telefon: (+49)-(0) 89/3 20 07-314
Fax: (+49)-(0) 89/3 20 07-450

E-Mail: ir@suss.de

www.suss.com



Gestaltung
strittmatter&jacobs GmbH & Co. KG, Köln

Druck
Schotte GmbH & Co. KG, Ürdingen

 **SÜSS** MicroTec AG